

TF-666

鹽基度: 1.3

相當規格:

EN ISO 14174 S AAB 1 68 AC H5

特性與用途:

TF-666 是一種適合於對接單層和多層的軟鋼、高張力鋼用鐳材，如使用於氧化膜較厚的鋼板上，仍擁有良好鐳道外觀和耐氣孔性，用於單、多極鐳接時，仍具有優異的耐電流性和鐳渣剝離性。

適用於造船、鋼構(H-Beam、Box)、橋樑等交、直流工件鐳接。

注意事項:

- (1) 鐳藥拆封使用，未用完的鐳藥，需保持乾燥以防止氣孔的發生。若鐳藥有受潮須將鐳藥放置於爐中，以 300~350°C 烘乾 1~2 小時。
- (2) 鐳藥重複使用時，請加入適量的新鐳藥混合使用，以確保良好的鐳道品質。

鐳道化學成份之一例(wt%):

搭配之線材	AWS A5.17	EN ISO 14171-A	C	Si	Mn	P	S
TSW-12KM	F7A2 -EM12K	S 42 3 AB S2Si	0.058	0.43	1.45	0.029	0.016
SubCor M13K	F7A6-EC1	-	0.06	0.3	1.46	0.027	0.010

鐳道機械性質之一例:

搭配之線材	降伏強度 MPa(ksi)	抗拉強度 MPa(ksi)	伸長率 %	衝擊值 J (ft-lbf)	溫度 °C(°F)	熱處理
TSW-12KM	454(66)	533(77)	33	60(44)	-30(-20)	--
SubCor M13K	452(66)	525(76)	35	55(41)	-51(-60)	--

* The information contained or otherwise referenced herein is presented only as "typical" without guarantee or warranty, and TienTai Electrode Co., Ltd. expressly disclaims any liability incurred from any reliance thereon. Typical data is obtained when welded and tested in accordance with AWS specification. Other tests and procedures may produce different results. No data is to be construed as recommendation for any welding condition or technique not controlled by TienTai Electrode Co., Ltd.